证券代码：688535　　证券简称：华海诚科　　公告编号：2026-006

江苏华海诚科新材料股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬与考核方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；其中，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》兼任高级管理人员的董事韩江龙、成兴明回避表决，其余出席会议的4名董事一致同意该议案。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏华海诚科新材料股份有限公司章程》等有关规定，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，具体情况公告如下：

一、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用范围

公司的董事、高级管理人员

（二）适用日期

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）组织管理

公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。

（四）薪酬标准

1、公司董事的薪酬

（1）独立董事

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年8万元（税前）。

（2）非独立董事

在公司担任除董事以外职务的非独立董事，薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，将根据其担任的具体职务，综合考虑公司薪酬水平、市场平均水平、公司经营和个人绩效确定，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

2、高级管理人员的薪酬

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（五）其他规定

1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放；

3、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；

4、公司2026年度董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施。

5、董事、高管如违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为给公司造成损失，或者对相关违法违规行为负有过错的情形，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。

6、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《江苏华海诚科新材料股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2026年3月18日

公司代码：688535　　公司简称：华海诚科

江苏华海诚科新材料股份有限公司2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，敬请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配方案为：公司拟以2025年度实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。截至2026年3月17日，公司总股本为96,014,323股，扣除公司回购专用证券账户中股份数276,815股后的公司股本95,737,508股为基数，以此计算合计拟派发现金红利人民币9,573,750.8元（含税），拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4.8股，不送红股。

如在公司2025年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配的利润总额和转增的公积金总额不变，相应调整每股分配比例和每股转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

上述2025年度利润分配方案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用　√不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	华海诚科	688535	/

1.2 公司存托凭证简况

□适用　√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董东峰	钱云
联系地址	连云港经济技术开发区东方大道66号	连云港经济技术开发区东方大道66号
电话	0518-81066978	0518-81066978
传真	0518-82366016	0518-82366016
电子信箱	ir@hhck-cm.com	ir@hhck-cm.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1. 主营业务

公司致力于半导体封装材料环氧塑封料和组装材料电子胶黏剂的研发、生产和销售。是国内少数芯片级固体和液体封装材料研发量产的专业工厂。依托公司的核心技术体系，公司形成了可覆盖传统封装领域与先进封装领域的全面产品布局。

2. 主营产品

公司主营产品包括环氧塑封料与电子胶黏剂，广泛应用于半导体封装、结构件封装、板级组装等应用场景。环氧塑封料（Epoxy Molding Compound，简称EMC）全称为环氧树脂模塑料，是用于半导体封装、结构件封装的一种热固性化学材料，是由环氧树脂为基体树脂，以高性能酚醛树脂为固化剂，加入硅微粉等填料，以及添加多种助剂加工而成，在半导体封装领域主要功能为保护半导体芯片不受外界环境（水汽、温度、污染等）的影响，并实现导热、绝缘、耐湿、耐压、支撑等复合功能。在结构件封装方面，公司系列产品可以应用在现代高功率电磁设备中，通过传递成型技术实现精密包覆，满足高温、高振动环境下的稳定运行需求，并顺应轻量化与集成化趋势，尤其适用于可再生能源装备（如风力发电机组），可显著降低旋转单元重量并提升结构强度。环氧塑封料应用于半导体及结构件封装环节，属于技术含量高、工艺难度大、知识密集型的产业环节；电子胶黏剂为半导体器件提供粘结、导电、导热、塑封等复合功能，可广泛应用于芯片粘结、芯片级塑封、板级组装等不同的封装环节，应用领域贯穿于一级封装、二级封装以及其他工业组装领域。

2.2 主要经营模式

1. 研发模式，公司的研发重点主要系半导体封装材料配方及生产工艺的开发与优化。在配方的开发过程中，公司需要结合不同封装形式对封装材料的性能要求及下游客户定制化需求，筛选出适合的原材料，确定各种物料的添加比例、添加顺序、混炼温度、混炼时间、混炼速度等生产工艺参数，从而在各理化性能指标的相互作用之间达到平衡，实现良好的综合性能。

2. 采购模式，公司设置采购部，综合计划部等部门，根据公司生产需要，针对半导体封装材料生产所需的原材料、辅料、备件、包材等物料进行采购。公司综合计划部门负责物料需求的计划平衡和编制，按月、周编制物料需求计划；由采购部会同研发、工程、质检相关部门商定原辅材料询价及供应商选择事宜；由采购部会同制造部、技改部、设备部商定设备、备品备件询价及供应商选择事宜。采购部门根据原材料需求计划，综合考虑合格供应商的交期因素，在对合格供应商进行询价、议价、比价的基础上选择合格供应商下单采购。

3. 生产模式，公司实行以销定产和需求预测相结合的生产模式，以确保生产计划与销售情况相适应。公司拥有专业的生产管理团队，根据客户提出的各类要求及时做出响应，并根据市场需求对产品种类和产量进行快速调整。

4. 销售模式：公司坚持以客户为中心，以直接客户为主、贸易商客户为辅。公司已建立了一支营销能力强、经验丰富的专业销售团队，形成了以华东、西南与华南地区为主，其他区域为辅的销售布局。新增子公司衡所华威依托其现有销售网络布局，已设立海外销售部，针对部分客户采用经销模式开展业务。报告期内，公司现有经营模式取得了良好的效果，产品与技术布局持续完善，业务规模快速增长，公司经营模式未发生重大变化，在可预见的未来也不会发生重大变化。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1.1 行业的发展阶段

公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括环氧塑封料与电子胶黏剂，主要应用于半导体封装、板级组装。根据国家统计局《2017年国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业——C3985 电子专用材料制造”。按照行业界的一般分类标准，公司所处行业为半导体材料行业。

封装材料是电子封装技术中不可或缺的组成部分，对半导体产业起着至关重要的作用，并直接影响着智能终端等下游产品的发展。

近年来，随着高性能计算（HPC）、人工智能（AI）和5G通信等技术的需求日益增长，电子产品进一步朝向小型化与多功能发展，芯片尺寸越来越小、芯片种类越来越多。后摩尔时代，芯片物理性能接近极限，提高技术节点的经济效益有所放缓。半导体行业焦点从提升晶圆制程节点向封装技术创新转移，WLCSP（晶圆级芯片规模封装）、FCCSP（倒装芯片级封装）、FCBGA（倒装芯片球栅阵列封装）、2.5D封装、3D封装、SiP（系统级封装）等先进封装技术的发展成为延续及超越摩尔定律、提升系统性能关键路径之一，先进封装技术的不断进步，对封装材料的要求也在不断提高，先进封装材料行业正迎来新的发展机遇，先进封装材料市场容量逐年增加，并有望持续增长。

1.2 基本特点

1.2.1 技术创新迭代速度快、门槛高。

一代封装一代材料。环氧塑封料的新产品开发需匹配下游封装技术持续提升的性能需求。公司研发、制造、销售的环氧塑封料与芯片级电子胶黏剂等封装材料是保证芯片功能稳定实现的关键材料，需要跟随下游封装形式的持续演进及客户的定制化需求而针对性地调整配方及生产工艺，又同时涉及高分子化学与物理、有机化学、无机非金属材料、电化学、表界面化学等多门学科的交叉，属于细分赛道产品，因此技术门槛较高。随着Chiplet、HBM等先进封装技术和工艺的不断发展，对于封装材料提出了更高的要求，各种先进封装技术对封装材料的性能需求不断提升，对公司的综合技术创新能力要求较高。

1.2.2 考核认证周期长，难进难出。

由于半导体封装材料对半导体器件的性能有显著影响，进而影响到终端产品的品质，因此一款新产品的批量供货，需要经过配方试制、客户的样品考核验证、批量验证后与客户达成正式合作。一个完整的新产品导入周期通常为3至6个月，长则可达3年以上。因此对封装材厂商的技术与服务要求较高。鉴于公司产品的关键性，发行人与下游封装厂商达成业务合作后，在产品品质稳定和合理的性价比的情况下，下游厂商一般不会更换半导体封装材料供应商，双方合作通常具备长期稳定性。

1.3 主要技术门槛

1.3.1 配方体系复杂，需要在多项性能需求间实现有效平衡。

环氧塑封料的配方体系较为复杂。在配方开发过程中，公司需在众多化合物中筛选出数十种原材料（包括主料及添加剂）进行复配，确定合适的添加比例，并充分考虑成本等因素以满足量产的需求。由于配方中任一原材料的种类或比例变动都可能导致在优化某一性能指标时，对其它性能指标产生不利影响（例如，通过添加填料提升填充性的同时会使流动性下降），因此，产品配方需要充分考虑各原材料由于种类或比例不同对各项性能造成的相互影响，并在多项性能需求间实现有效平衡，以保证产品的可靠性。

1.3.2 环氧塑封料产品具有定制化的特点。

由于不同客户或同一客户不同产品的封装形式、生产设备选型、工艺控制、前道材料选用、可靠性考核要求及终端应用场景等方面存在差异，对环氧塑封料的各项性能指标都有独特的要求，公司下游封装厂商对环氧塑封料的需求呈现定制化特征。因此，公司需要通过针对性地优化与调整配方或生产工艺，对客户需求中所涉及的个性化技术难点进行攻坚，以满足客户针对工艺性能（如固化时间、流动性、冲丝、连续成模性、气孔率、分层、翘曲等）以及应用性能（如可靠性、热性能、电性能等）的定制化需求。

1.3.3 环氧塑封料的新产品开发需匹配下游封装技术持续提升的性能需求

由于历代封装技术及不同的应用领域对环氧塑封料的性能要求均存在差异，环氧塑封料厂商需以下游技术的发展为导向，持续开发在理化性能、工艺性能以及应用性能等方面与历代封装技术相匹配的新产品，故而业内呈现出“一代封装，一代材料”的特点。封装技术的持续演进对环氧塑封料提出了更多、更严苛的性能要求。其中，先进封装中的QFN/BGA、FOWLP/FOPLP等因其不对称封装形式而增加了对环氧塑封料的翘曲控制要求，同时要求环氧塑封料在经过更严苛的可靠性考核后仍不出现任何分层且保持芯片的电性能良好。因此，公司在应用于先进封装产品的配方开发中需要在各性能指标间进行更为复杂的平衡（例如，需要进一步考虑Tg、CTE与应力间的相互影响以实现翘曲控制），对塑封料厂商的自主创新能力与技术储备要求进一步提升，产品开发难度进一步加大。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

自2010年成立以来，公司始终专注于半导体封装材料的研发及产业化，10余年来公司深耕半导体封装材料的研发创新，核心技术为配方技术及其相应的生产工艺技术，产品可广泛应用于传统封装与先进封装领域，技术储备丰富且具有前沿性，可满足各种主流封装技术的需求，为客户提供有力的技术支撑。

当前行业呈现先进封装提速、功率器件高压化、国产替代深化三大趋势，公司紧跟下游封装行业的发展趋势，以客户需求为导向，对相关技术难点进行持续攻坚，形成适合各类封装形式的全系列产品与技术布局。在传统封装领域，公司产品结构全面并已实现产业化，市场份额逐步扩大，在国内市场已具备较高的品牌知名度及市场影响力；在先进封装领域，颗粒状环氧塑封料（GMC）、FC底填胶、高导热、低翘曲、耐高压、高可靠性等系列产品已陆续通过客户考核验证，技术水平取得业内主要封装厂商的认可。公司在加大核心技术开发的同时，注重实现核心技术的产业化公司拥有独立自主的系统化知识产权。凭借扎实的研发实力、可靠的产品质量和优质的客户服务，公司已与长电科技、通富微电、华天科技、银河微电、扬杰科技、利普芯等业内领先及主要企业建立稳固的合作伙伴关系，业务规模持续扩大，有序实现研发技术的产业化落地，推动经营业绩的快速提升。公司与业内主流封装厂商均已建立长期稳定的合作关系。

报告期内公司完成对衡所华威的并购整合，合并后公司在半导体环氧塑封料领域的年产销量突破25,000吨，稳居国内龙头地位，跃居全球同行出货量第二位。作为华海诚科旗下子品牌，衡所华威保留其在国内车规级市场的绝对主导权；GR750X1专为1200V碳化硅功率模块开发的高Tg（200℃）特种结构环氧固化体系，已规模化应用于全球TOP5功率器件厂商，成为高压电驱系统的高性能封装材料之一。在先进封装领域，衡所华威和韩国子公司的颗粒状环氧塑封料（GMC）在存储器件领域取得突破。衡所GR910系列产品已在NAND FLASH通过考核并实现批量供货；韩国子公司具备开发HBM所要求的高导热EMC的技术能力，有望直接切入全球AI算力芯片供应链。技术协同上，衡所华威的低应力配方与华海诚科成熟的GMC造粒工艺深度融合，构建“车规+先进封装”双引擎模式，客户版图从传统功率模块扩展至AI与存储领域。

江苏连云港总部与韩国生产基地构成“双核制造体系”，2025年海外收入大幅增加，实现从“国产替代”到“全球供应”的战略升维。衡所华威的整合，标志着中国EMC产业从分散攻关迈向系统性主导，首次具备定义下一代封装材料标准的能力，成为全球半导体材料格局重构的关键变量。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2025年，世界半导体产业迎来重要发展机遇，AI、汽车电子等半导体应用领域迎来爆发式增长。在AI服务器、数据中心服务器等需求的推动下，半导体先进工艺技术、先进封装技术将得到进一步发展。预计2026年世界半导体产业销售收入将有明显增长。但是在经贸摩擦、关税战等日益加剧的情况下，世界半导体供应链稳定性受到严峻挑战，尤其是各国对高端设备、关键材料、EDA工具等方面的相互制约，影响了世界半导体产业按市场规律健康发展。产业链供应链重塑将成为2026年世界各国半导体业界关注的焦点。

环氧塑封料作为半导体封装的核心材料，已从传统“保护壳”角色全面跃升为先进封装技术的关键使能材料，在技术突破、产业协同、业态创新三大维度实现系统性升级。先进封装占比将逐步超越传统封装，先进封装材料成为主流。随着电子产品进一步朝小型化与多功能发展，芯片尺寸越来越小、芯片种类越来越多，其中输出/入脚数大幅增加，使得倒装焊、圆片级、系统级、扇出型、2.5D/3D、Chiplet等先进封装技术成为延续摩尔定律的最佳选择之一，先进封装技术在整个封装市场的占比正在逐步提升。

从新技术方面来看，高性能材料实现量产突破。2025年，国产EMC在低CTE、高导热、颗粒状（GMC）等前沿材料领域实现规模化落地。华海诚科完成颗粒状EMC（GMC）关键装备迭代，实现连续稳定生产，满足FOWLP、FOPLP等扇出型封装的高流动性需求；高导热EMC通过氧化铝改性，导热系数突破3W/m·K，支撑大功率器件的热管理；液态EMC（LMC）开始测试。

从新产业来看，AI与车规驱动需求结构重塑。AI算力芯片成为最大增量引擎，存储芯片封装对EMC的低α粒子含量、高纯度填料提出严苛要求。新能源汽车领域，车规级IGBT/IPM模块用EMC需求逐年增长。另外，环氧塑封料因其良好的机械支撑性、导热性及耐油耐盐腐蚀性等优势，在模塑集成散热通道与定位槽方面，可以满足下游场景“结构-绝缘-散热”三合一的应用要求，已在部分大型车企的结构部件上实现大批量稳定供货。

从新业态来看，材料-封装-设计协同创新。EMC厂商不再仅是材料供应商，而是深度参与芯片-封装协同设计。华海诚科已进入长电科技、通富微电等头部封测企业供应链体系。2025年，其QFN、BGA、MUF等中高端产品销量同比大幅增长，客户覆盖主流封测厂。同时，“定制化认证+快速交付”成为新服务模式，终端设计厂直接指定EMC型号，推动国产材料进入核心供应链。

从新模式来看，国产替代从“替代”迈向“定义”。环氧模塑料属于国家《“十四五”原材料工业发展规划》中明确支持的关键战略材料，上海、江苏等地设立专项基金支持材料-设备-封测协同创新。国产EMC正从“能用”走向“更好用”，并开始定义下一代封装标准，标志着中国在半导体材料领域从“跟跑”转向“并跑”。

根据美国半导体行业协会（SIA）发布数据，受AI投资需求拉动，2025年1-12月全球半导体行业销售额再创历史新高，达到7,917亿美元，同比增长25.6%，其中2025年第四季度全球半导体市场销售额为2,366亿美元，较2024年第四季度同比增长37.1%，较2025年第三季度环比增长13.6%。预计2026年全球半导体市场销售额将实现加速增长至9,754亿美元。市场研究机构Gartner发布的预测数据更为乐观，其预测2026年全球半导体市场收入将达到10,331亿美元，同比增长33.78%。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,158,289,524.07	1,402,647,705.52	125.17	1,230,461,176.67
归属于上市公司股东的净资产	2,173,747,829.20	1,039,069,276.16	109.20	1,027,268,796.58
营业收入	458,055,907.14	331,634,930.76	38.12	282,902,181.17
利润总额	20,058,875.20	43,809,642.77	-54.21	33,787,212.26
归属于上市公司股东的净利润	24,252,132.96	40,063,058.84	-39.47	31,638,634.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,687,619.60	34,132,299.37	-42.32	27,396,679.83
经营活动产生的现金流量净额	7,676,254.53	2,976,498.49	157.90	31,605,240.29
加权平均净资产收益率(%)	2.22	3.89	减少1.67个百分点	3.68
基本每股收益(元/股)	0.30	0.50	-40.00	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.50	-40.00	0.42
研发投入占营业收入的比例(%)	10.93	7.96	增加2.97个百分点	8.71

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	83,874,474.65	95,201,506.50	100,169,338.73	178,810,587.26
归属于上市公司股东的净利润	7,208,777.38	6,565,756.90	6,275,888.24	4,201,710.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,560,041.69	6,139,317.61	6,056,019.38	932,240.92
经营活动产生的现金流量净额	-2,345,166.56	-387,051.81	1,121,003.31	9,287,469.59

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	14,739
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,116
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
韩江龙	12,000	11,253,799	11.72	11,241,799	无	0	境内自然人
连云港德裕丰投资合伙企业（有限合伙）	0	10,308,091	10.74	10,308,091	无	0	其他
杨森茂	-1,396,364	3,993,807	4.16	0	无	0	境内自然人
陶军	12,000	3,471,500	3.62	3,459,500	无	0	境内自然人
成兴明	12,000	3,243,515	3.38	3,231,515	无	0	境内自然人
天水华天科技股份有限公司	-641,953	2,615,623	2.72	0	无	0	境内非国有法人
绍兴署辉贸易有限公司	2,577,748	2,577,748	2.68	2,577,748	冻结	1,380,000	境内非国有法人
上海衡所半导体材料有限公司	2,078,892	2,078,892	2.17	2,078,892	无	0	境内非国有法人
中汇人寿保险股份有限公司-分红产品	1,082,120	1,082,120	1.13	1,082,120	无	0	其他
钱方方	-189,545	885,455	0.92	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司董事陶军为连云港德裕丰投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。(2)韩江龙、成兴明、陶军三人通过连云港德裕丰投资合伙企业（有限合伙）控制的表决权比例为10.74%，且上述三人签订了《一致行动人协议》，因此韩江龙、成兴明、陶军及连云港德裕丰投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。(3)除上述情况外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

存托凭证持有人情况

□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

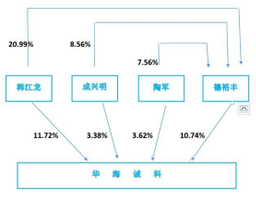
□适用　√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入45,805.59万元，同比增长38.12%；归属于上市公司股东的净利润2,425.21万元，同比下降39.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,968.76万元，同比下降42.32%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：688535　　证券简称：华海诚科　　公告编号：2026-007

江苏华海诚科新材料股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金

中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,018万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币35.00元，募集资金总额为人民币706,300,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币73,361,785.82元后，实际募集资金净额为人民币632,938,214.18元。

上述募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年3月31日出具《验资报告》（中汇会验[2023]2314号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2023年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华海诚科首次公开发行股票科创板上市公告书》。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金45,222.97万元，募集资金专户余额合计为20,085.68万元（含利息收入扣除银行手续费的净额），具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元　币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年3月30日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	706,300,000.00
其中：超募资金金额	302,915,114.18
减：直接支付发行费用	73,361,785.82
二、募集资金净额	632,938,214.18
减：	
以前年度已使用金额	404,018,970.96
本年度使用金额	48,210,741.45
暂时补流金额	-
现金管理金额	200,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	8,984.60
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	19,999,007.53
其他-已使用一般产支付的印花税	158,274.12
其他-发行费用发票尾差调整	0.41
三、报告期期末募集资金余额	856,799.23

2、发行股份募集配套资金

经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2106号），公司发行股份募集配套资金的发行股票数量为9,618,852股，每股发行价格为人民币83.17元，募集资金总额为人民币799,999,920.84元，扣除各项发行费用人民币18,294,193.08元，实际募集资金净额为人民币781,705,727.76元。上述募集资金已于2025年12月10日到账，到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2025年12月11日出具《验资报告》（中汇会验〔2025〕11801号）。

根据相关法律法规的要求，公司及全资子公司衡所华威电子有限公司（以下简称“衡所华威”）对本次发行的募集资金进行专户存储，并已与财务顾问中信建投证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-085）。

截至2025年12月31日，公司使用募集资金33,845.00万元，募集资金专户余额合计为46,155.90万元（含利息收入扣除银行手续费的净额），具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元　币种：人民币

发行名称	2025年发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金之配套募集资金
募集资金到账时间	2025年12月10日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	799,999,920.84
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	18,294,193.08
二、募集资金净额	781,705,727.76
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	320,155,806.92
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	1,041.41
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入	10,109.49
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	461,558,988.92

注：本年度使用金额已剔除本年度支付的发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定，制定了《募集资金管理制度》。

1、首次公开发行股票募集资金

公司已于2023年3月与募集资金专户监管银行中国光大银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司连云港分行、上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行、交通银行股份有限公司连云港分行及保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、发行股份募集配套资金

公司及全资子公司衡所华威已于2025年12月与存放募集资金的开户银行浙商银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司连云港分行、上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行、中国银行股份有限公司连云港经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司连云港新区支行及财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元　币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023年3月30日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏华海诚科新材料股份有限公司	上海浦东发展银行有限公司连云港分行	200100788012000032 08	116,223.16	使用中
江苏华海诚科新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司连云港分行营业部	518900004910888	12,026.34	使用中
江苏华海诚科新材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司连云港分行	638293365	12,125.47	使用中
江苏华海诚科新材料股份有限公司	交通银行股份有限公司连云港科技支行	327006012013000021584 7	716,379.07	使用中
江苏华海诚科新材料股份有限公司	中国光大银行股份有限公司连云港分行	57360180803999505	45.19	使用中

注：截至报告披露日，公司浦发银行账户（200100788012000032 08）已注销，招商银行账户（518900004910888）和光大银行账户（57360180803999505）待注销。

2、发行股份募集配套资金

截至2025年12月31日，本公司发行股份募集配套资金有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元　币种：人民币

发行名称			2025年发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金之配套募集资金	
募集资金到账时间			2025年12月10日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏华海诚科新材料股份有限公司	浙商银行股份有限公司南京分行	3070000010120100083938	165,246,324.56	使用中
江苏华海诚科新材料股份有限公司	交通银行股份有限公司连云港分行	327006012015003037074	105,099,305.66	使用中
江苏华海诚科新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行	20010078801000004012	88,102,345.99	使用中
江苏华海诚科新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司连云港经济技术开发区支行	489783078886	52,889,308.02	使用中
江苏华海诚科新材料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司连云港新区支行	1107020029285556610	50,221,704.69	使用中
衡所华威电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司连云港分